



Panasonic Electronic Materials Division launches a new product brand for the Semiconductor Device Materials business. The IC substrate materials' brand is transitioning from MEGTRON GX to LEXCM GX. パナソニック 電子材料事業部は、新たに半導体デバイス材料の製品ブランドを LEXCM(レクシム)としてスタートします。それに伴い、半導体パッケージ基板材料は MEGTRON GX から LEXCM GX へ変更いたします。

High elasticity Low CTE IC substrate materials

高弾性・低熱膨張半導体パッケージ基板材料

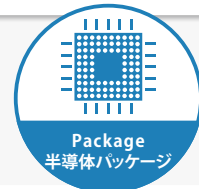
LEXCMGX

Laminate R-1515W

Prepreg R-1410W

Applications 用途

IC substrate
半導体パッケージ基板



Achieve more functionality (multi-pin and integrated circuit) the large-sized Package by excellent modulus and highly heat resistant property.

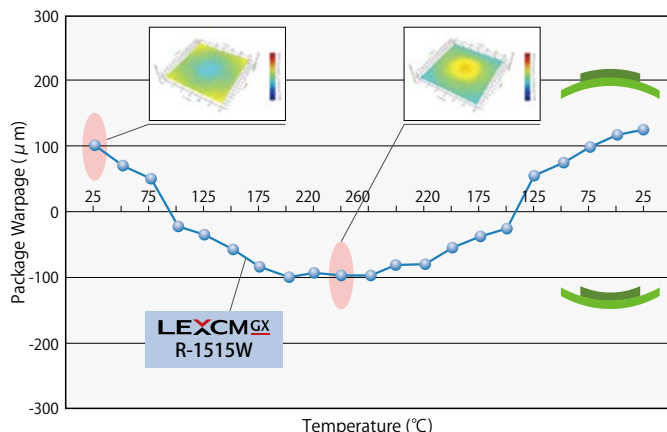
優れた弾性率と更なる耐熱性を付与し、多ピン化・伝送回路集積化に伴う大型パッケージの高機能化に貢献

Flexural modulus
25°C 35GPa

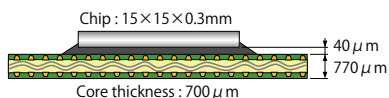
CTE x, y-axis
8-10ppm/°C

Tg (DMA)
250°C

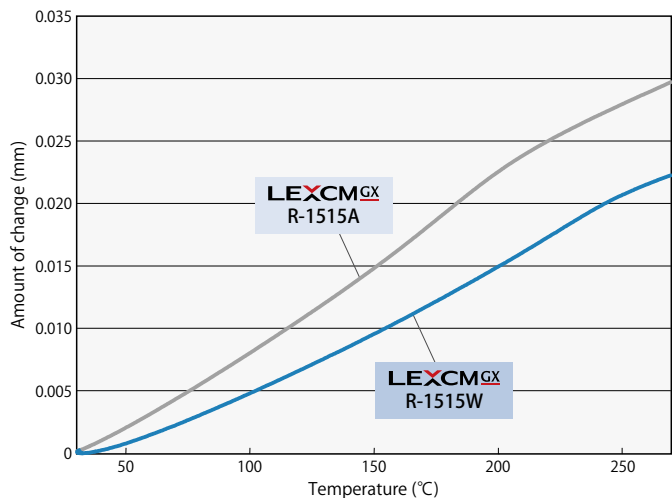
Package warpage パッケージ基板反り評価結果



Construction



Thermal expansion(x-axis) 熱膨張量(タテ方向)



Length : 10mm
Thickness : 0.8mm (8ply)
Method : TMA

General properties 一般特性

Item	Test method	Condition	Unit	LEXCMGX R-1515W
Glass transition temp.(Tg)	DMA*2	A	°C	250
Thermal decomposition temp.(Td)	TGA	A	°C	390
CTE x-axis	α 1	Internal method	ppm/°C	8-10
CTE y-axis				8-10
CTE z-axis	α 1	IPC-TM-650 2.4.24	A	22
	α 2			97
Flexural modulus*1	JIS C 6481	25°C	GPa	35
		250°C		21

The sample thickness is 0.1 mm.
*1 0.8mm *2 measurement in bending mode

Our Halogen-free materials are based on JPCA-ES-01-2003 standard and others. 当社ハロゲンフリー材料は、JPCA-ES-01-2003などの定義によるものです。The above data are typical values and not guaranteed values. 上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。

Please see the page for "Notes before you use" 商品のご採用に当たっての注意事項はこちら